

TEPIC

● 特長 Characteristics

■ 透明性、耐熱性、耐光性

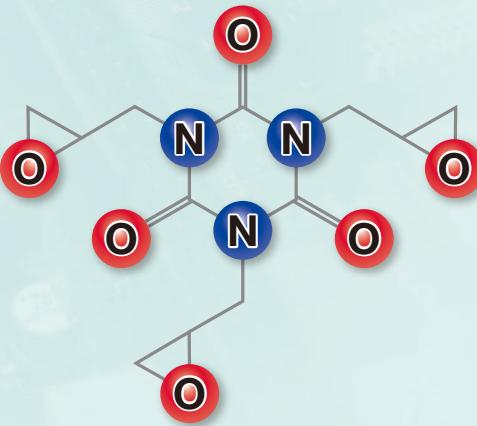
High transparency, high heat resistance, and high light resistance

■ 高弾性率

High modulus

■ 高 Tg

High Tg



● グレード Grade

品番 Grade	TEPIC-S	TEPIC-SS	TEPIC-SP	TEPIC-HP
特長 Characteristics	基本グレード Basic grade	低塩素 Low chlorine	小粒径 Small particle	高融点 High melting point
外観 Appearance	粉体 Powder	粉体 Powder	微粉 Fine Powder	微粉 Fine Powder
粒径 (μm) Particle size	<350	<350	<3 (Median) Approx.10 (Max)	<5 (Median) Approx.20 (Max)
融点 (℃) Melting Point	98-120	98-120	98-120	153-157
エポキシ当量 (g/eq) Epoxy equivalent ratio	<105	<105	<105	<102
塩素 (ppm) Chlorine	<850	<300	<850	<250

● 硬化物物性 Property of thermosetting resin

項目 Item	TEPIC-S	ビスA型エポキシ ¹⁾ BPA epoxy	脂環式エポキシ ²⁾ Alicyclic epoxy
Tg (℃) ³⁾	245	166	240
曲げ強度 (MPa) Flexural strength	135	122	128
たわみ量 (mm) Flexural length	9	27	11
曲げ弾性率 (MPa) Flexural modulus	3,840	2,920	3,400
線膨張係数 (ppm/℃) CTE	71	68	74

<硬化条件>

硬化剤: リカシッド MH-700 (新日本理化株式会社)、硬化促進剤: ヒシコーリン PX-4ET (日本化学工業株式会社) 1phr
硬化時間: 150℃

1) jER828 (三菱ケミカル株式会社)、2) セロキサイド 2021P (株式会社ダイセル)、3) DMAにより測定

● 主な用途 Application

■ LED周辺材料 (透明封止材、リフレクター材)

Transparent encapsulant or reflector for LED

■ ソルダーレジストインキ

Solder resist ink

■ 粉体塗料硬化剤

Curing agent for powder coating

■ CFRPマトリクス樹脂

Matrix resin for CFRP

記載の数値は代表値です。保証値ではありません。



日産化学株式会社